



TIF™ 92500导热垫能填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

特性

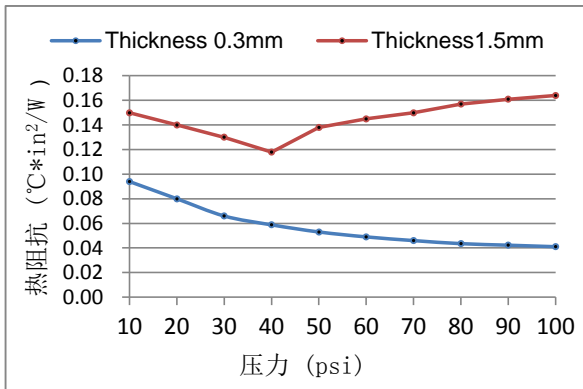
- 》良好的热传导率
- 》良好的热稳定性
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

应用

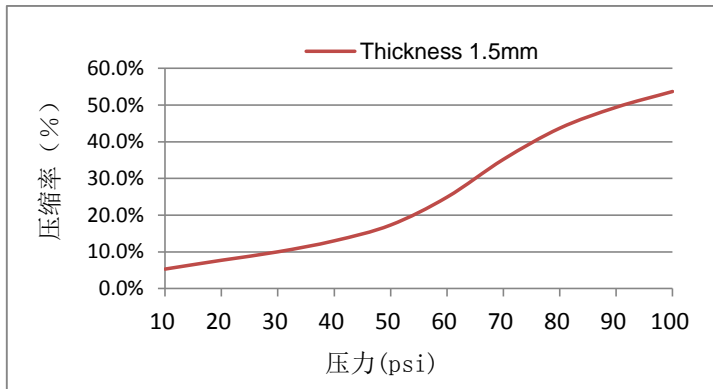
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

TIF™92500导热垫 系列特性表		
颜色	黑色	Visual
结构&成份	石墨填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.012"(0.3mm)~0.20" (5.0mm)	ASTM D374
硬度Shore 00	60	ASTM 2240
比重 (g/cm³)	1.8	ASTM D792
使用温度范围	-40~200℃	IEC60068-2-14
热传导率	25 W/mK	ASTM D5470
	25 W/mK	ISO22007-2.2
热阻抗 (°C*in²/W) (@20psi,0.3mm)	≤0.08	ASTM D5470
体积电阻率 (Ω*mm)	<200	ASTM D257
RoHS	符合	IEC62321

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.012"(0.30mm), 0.02"(0.50mm), 0.03"(0.75mm), 0.04"(1.00mm),
0.06"(1.50mm), 0.08"(2.00mm), 0.10"(2.50mm), 0.12"(3.00mm),
0.14"(3.50mm), 0.16"(4.00mm), 0.18"(4.50mm), 0.20"(5.00mm),

标准厚度: 最大标准尺寸80mm*80mm

TIF92500系列产品可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

导热介面材料
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

导热材料

发热材料

导热工程塑料

发泡硅胶

模切制品

加拿大:
Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

中国:
Tel: +86-769-38801208
E-mail: frances@ziitek.com.tw

台湾:
Tel: +886-2-22771007
E-mail: frances@ziitek.com.tw